

DII Program

'Solution Design Phase' SEMINAR

表題: 半導体メーカーで今起きていることとは

I 部(15:50-16:50) Siを凌駕する化合物半導体デバイスが作る未来

II 部(17:00-18:00) 次世代を共に作る皆さんへ-あなたの型ってありますか？

日時: 2023年2月3日(金) 15:50-18:00

場所: 名古屋大学 IB電子情報館 IB014講義室

講師:

I 部: 鶴山元規(ローム株式会社 LSI事業本部 パワーステージ商品開発部 グループリーダー)

II 部: 山口雄平(ローム株式会社 LSI事業本部 パワーステージ商品開発部 部長)

カテゴリ: 2

言語: 日本語

概要

自分の行っている研究がどのように社会で活かされるのか？

そのような疑問を持ったことはないでしょうか？

大学時代に持っていた働くことに対するイメージと社会人になって見えてくる現実の違いを各々の立場で実体験に基づいて伝えます。

I 部(15:50-16:50)

半導体業界では、長年シリコンによる製品開発が主流で行われています。

一方で、パワーエレクトロニクスと呼ばれる高電力分野の成長が注目されています。

ここで使われる半導体部品は、従来のシリコン製品から化合物半導体であるシリコンカーバイド(SiC)やガリウムナイトライド(GaN)が注目されています。本講義では、その違いを物性値から読み解き今後予想される市場の動向を実体験を基に話します。

鶴山元規氏

2011年3月大阪大学大学院工学研究科を修了し、4月ロームへ入社。入社後は、TV向けの電源IC(PMIC)の開発にアナログ回路設計者として従事。2014年8月、回路技術の先行開発部署創設(電源技術プロジェクト)にあたり社内公募を経て異動。先端回路技術開発と並行し、社内技術のブランディング化を推進。2022年7月パワーステージ商品開発部へ異動し、新規事業立ち上げであるGaNを用いた製品開発を担当し、現在に至る。



DII Program

'Solution Design Phase' SEMINAR

Ⅱ部(17:00-18:00)

如何にして、世界一の技術製品を作り上げたのか？

それを支えている技術はどのようなものなのか？

今後の市場動向と市場を動かす戦略とはどのようなものか？

半導体メーカーの開発現場と業界内で起きている現場の今について話をします。

山口雄平氏

2008年3月大阪大学大学院基礎工学研究科を修了し、

4月ロームへ入社。入社後は、車載向けのスイッチング

電源ICの開発向けにアナログ回路設計者として従事。

2014年8月、回路技術の先行開発部署創設(電源技術

プロジェクト)にあたり社内公募を経て異動。先端回路

技術開発と並行し、社内技術のブランディング化を推進。

2021年6月パワーステージ商品開発部と兼務を開始。

GaNを用いた新規事業の責任者として事業の立ち上げを

担当、現在に至る。

